

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年10月11日(2012.10.11)

【公開番号】特開2012-4464(P2012-4464A)

【公開日】平成24年1月5日(2012.1.5)

【年通号数】公開・登録公報2012-001

【出願番号】特願2010-139998(P2010-139998)

【国際特許分類】

H 01 L 21/60 (2006.01)

H 01 L 25/065 (2006.01)

H 01 L 25/07 (2006.01)

H 01 L 25/18 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/60 301D

H 01 L 21/60 301B

H 01 L 25/08 Z

【手続補正書】

【提出日】平成24年8月21日(2012.8.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項4】

前記第1半導体素子の前記第1電極が設けられる側の主面に積層された第2半導体素子をさらに備え、

前記第2電極は、前記第2半導体素子に電気的に接続され、

前記ワイヤは、前記第1電極の上方と、前記第2電極の上方と、の間ににおいて、前記第1半導体素子の主面及び前記第2半導体素子の主面に対して実質的に平行であることを特徴とする請求項1～3のいずれか1つに記載の半導体装置。